

Energy efficient

from Cloud to the Edge

10.24 限定 展場好康大放送！
Lucky Draw on the 24th Only!



現場好禮抽獎與冰淇淋派對

最終辦法請依官網為主

INVITED BY _____ BOOTH NO. _____

INVITATION

TPCA Show

— TAIPEI —



2025 OCT. 22 WED-24 FRI.
台北南港展覽館一館（一樓、四樓）TaiNEX 1, TAIPEI
10:00 - 17:00 (Final Day 15:00)

特別展示 Special Exhibition

終端應用 End Applications

- 電腦 Computing
- 通訊 Communication
- 車載 Automotive
- 航太/軍用 Aerospace and Defense
- 消費性電子 Consumer Electronics



AI與智能製造應用 AI and intelligent manufacturing applications

- AI封裝檢測 AI package inspection
- AI軟體開發 AI software development
- Edge AI
- 機器人 robot



熱管理與熱像應用 Thermal management and thermal imaging applications

- 紅外線感測器製程 Infrared sensor process
- 模組封裝 Module packaging
- 光學系統及產品應用 Optical systems and product applications



先進製程與高階封裝 Advanced Processes and Advanced Packaging

- CoWoS, CoPos
- FOPLP
- TGV & Glass Core



以上展商僅為隨機呈現，完整名單請上網查詢 all exhibitors are on www.tpcashow.com

全球電子產業正在加速跨界融合，從PCB、SMT、載板到高階封裝與半導體製程，規模再創歷史新高，逾670+國際品牌、1750個攤位，TPCA Show正是您一站式掌握供應鏈最新技術、材料與夥伴的最佳平台。我們誠摯邀請您於2025年10月22日至24日親臨台北南港展覽館一館，與來自全球的技術專家、創新企業及潛在合作夥伴共聚盛會。

TPCA Show is the leading international exhibition bridging the entire value chain from PCBs, SMT, thermal solutions, substrates to advanced packaging and AI-driven manufacturing. Join us in Taipei and explore what's next.

9 大主題分區

IC Substrates, Thermal, Green Tech, Automation, etc.



載板與高階電路板製造本業區
IC Substrate & PCBs



光電專區
OPTO Pavillion



乾、溼製程設備
Dry & Wet Process Equipment



自動化解決方案
Automation Equipment



高質新材料、耗材與化學品
Materials & Chemicals



綠色科技區
Green Tech



SMT/熱管理技術
SMT / Thermal Management



檢測設備與軟體
Testing Equipment



矽光子專區
HiSPA Pavillion

更多訊息請至官網 For more information Website : www.tpcashow.com

活動介紹 Activity

- 開幕典禮暨主題演講《產業領航者的AI供應鏈戰略》
Opening Ceremony & Keynote: "AI-Driven Supply Chain Strategies by Industry Leaders"
- 產業領袖高峰會 **CEO Summit**：與決策者直接對話
- 半導體與PCB異質整合高峰論壇：
Semiconductor X PCB Summit
- 洞察未來趨勢 **Tech X Total solution**
 - Pack Vision 封裝視界 (CoWoS, CoPoS, Packaging, IC Substrates...)
 - Smart Link 智聯製造 (AI、IoT、數智製造、機器人、AI檢測與軟體...)
 - Next Core 次世代核心 (TGV、Glass Core、FoPLP...)
 - Hyper Edge 高速邊緣 (HPC、5G、伺服器、熱管理與應用)
 - Auto Next 車用科技 (EV與車用電子)
 - Green Tech 綠能科技 (永續與淨零)
- 人才原力媒合=電路板 X Z世代人才
Digital Talent Match Day



鼓勵搭乘大眾交通工具，攜手減碳共創環境永續，一起參與綠色看展！
Take rapid transportation, make this world green.



謝絕18歲以下及非相關行業民眾入場參觀。
Under 18 not admitted.



IMPACT Oct. 21-24
International Microsystems, Packaging,
Assembly and Circuits Technology conference



www.impact.org.tw